证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2021-013

锦州神工半导体股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 14 日　14 点 0 分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日

至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
10	《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688233	神工股份	2021/5/6

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人／执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人／执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 10 日上午 8 时 30 分至 12 时 00 分，下午 13 时 00 分至 17 时 00 分。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，建议股东通过网络投票方式进行投票。

（二）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

（四）会议联系方式：

1、联系地址：辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲

2、联系电话：0416-7119889

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

锦州神工半导体股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 14 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》			
10	《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2021-014

锦州神工半导体股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2 亿元(含本数)人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资品种

为控制风险，理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）额度及期限

本次公司拟使用最高额不超过 2 亿元(含本数)的闲置自有资金购买理财产品，决议自董事会审议通过之日起 12 个月(含 12 个月)内有效，在有效期内资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度、投资期限及投资品种内，董事会授权董事长决定具体的理财事宜，签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、流动性好投资产品。

2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2021 年 4 月 16 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

（二）监事会审议情况及意见

2021 年 4 月 16 日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体监事表决，一致同意了该议案。

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开展及确保资金安全的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2021-011

锦州神工半导体股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于 2021 年 04 月 16 日通过现场的方式召开。会议已于 2021 年 04 月 06 日通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席哲凯召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事表决，一致同意形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，我们作为公司监事认为：

1、公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。能够客观、真实地反映公司 2020 年度的经营情况。

2、经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司 2020 年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

3、我们保证和承诺，公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司 2020 年年度报告及摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司 2020 年年度报告及摘要的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会按照《公司法》《锦州神工半导体股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，编制了《锦州神工半导体股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2020 年年度经营及财务状况，公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。不进行公积金转增股本，不送红股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 16,000,000.00 元(含税)。占公司 2020 年度合计报表归属于上市公司股东净利润的 15.96%。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

2020 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司编制了《锦州神工半导体股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于变更公司营业范围并修订＜公司章程＞的议案》

经审议，同意通过《关于变更公司营业范围并修订＜公司章程＞的议案》。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于变更公司营业范围并修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 2 亿元(含本数)人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月(含 12 个月)，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

锦州神工半导体股份有限公司

监事会

2021 年 04 月 16 日

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2021-012

锦州神工半导体股份有限公司 关于变更公司营业范围 并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司营业范围并修订＜公司章程＞的议案》，上述议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司营业范围变更相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：“生产、销售半导体级硅制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

拟变更经营范围：“新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十三条　经依法登记，公司的经营范围：生产、销售半导体级硅制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十三条　经依法登记，公司的经营范围：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；销售代理；进出口代理；贸易经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 16 日

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2021-010

锦州神工半导体股份有限公司 2020 年度募集资金实际存放 与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可 2020[100]号)核准，锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)采用战略配售、网上网下方式发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，发行价格为每股 21.67 元。截止 2020 年 2 月 17 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股，募集资金总额 866,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 76,049,433.93 元后的 790,750,566.07 元已于 2020 年 2 月 17 日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行 0708004329200067771 账户 300,000,000.00 元，存入锦州银行股份有限公司金凌支行 410100692121518 账户 300,000,000.00 元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部 392212010160740453 账户 190,750,566.07 元；减除审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,881,132.08 元后，实际募集资金净额为人民币 774,869,433.99 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2020]第 1-00010 文号的验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本公司募集资金总额 866,800,000.00 元，扣减承销保荐费后实际到账金额为 790,750,566.07 元。使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用共计人民币 50,626,169.00 元，本年度使用 133,345,509.43 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 9,024,133.58 元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
募集资金总额	866,800,000.00
减：承销、保荐费	76,049,433.93
实际到账金额	790,750,566.07
减：支付其他发行费用	13,212,264.02
减：前期支付律师会计师等的发行费用	2,668,868.06
减：前期投入募集资金置换	34,745,036.92
减：本期募集项目支出	133,343,062.95
减：暂时闲置资金进行现金管理投资	600,000,000.00
加：利息收入及现金管理投资收益	2,245,245.94
减：手续费支出	2,446.48
截止 2020 年 12 月 31 日止募集资金余额	9,024,133.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的规定存放、使用、管理资金。

2020 年 2 月，中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行、锦州银行股份有限公司金凌支行、锦州农村商业银行股份有限公司营业部、国泰君安证券股份有限公司、公司签订募集资金专户存储三方监管协议。监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照该监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户使用人	存放金额	备注
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200067771	锦州神工半导体股份有限公司	37,305.78	活期
锦州银行股份有限公司金凌支行	410100692121518	锦州神工半导体股份有限公司	372,569.54	活期
锦州农村商业银行股份有限公司营业部	392212010160740453	锦州神工半导体股份有限公司	8,614,258.26	活期
合　计			9,024,133.58	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募投项目实际使用募集资金 168,090,546.35 元，具体详见“募投资金使用情况对照表”(见附件 1)。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司前期募投项目投入资金置换 34,745,036.92 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 3 月 2 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过 60,000 万元(包含本数)的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用，本事项无需提交股东大会审议。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构存款	300,000,000.00	2020-3-3	2021-2-26	否
锦州银行股份有限公司金凌支行	定期存单	300,000,000.00	2020-3-3	2021-3-3	否

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司不存在变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的审核报告的结论性意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为，神工股份公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了神工股份募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：神工股份 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网公告附件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；

2、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《锦州神工半导体股份有限公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的审核报告》(大信专审字[2021]第 1-10233 号)。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况表

锦州神工半导体股份有限公司

董事会

2021 年 04 月 16 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			77,486.94					本年度投入募集资金总额		13,410.18	
报告期内变更用途的募集资金总额			–					已累计投入募集资金总额		16,809.05	
累计变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1. 研发中心建设项目	否	23,276.81	17,486.94	17,486.94	8,974.76	12,373.63	–5,113.31	70.76		不适用	是	否
2. 8 英寸半导体极硅单晶抛光片生产建设项目	否	86,923.41	60,000.00	60,000.00	4,435.42	4,435.42	–55,564.58	7.39		不适用	是	否
承诺投资项目小计		110,200.22	77,486.94	77,486.94	13,410.18	16,809.05	–60,677.89	21.69				
超募资金投向	不适用											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
超募资金的金额、用途及使用情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 37,413,904.98 元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用募集资金用途及去向	闲置资金盈余管理或募集资金专户存储											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

证券代码：688233　　证券简称：神工股份　　公告编号：2021-007

锦州神工半导体股份有限公司 关于 2020 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。主要原因为综合考虑目前公司所处行业特点及公司发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 159,792,842.62 元。经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至公告日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,000,000.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 15.96%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 100,276,468.28 元，公司累计未分配利润为 159,792,842.62 元，公司拟分配的现金红利总额为 16,000,000.00 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

公司本年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

（一）公司所处行业情况及特点

2020 年半导体行业发展处于上行周期。半导体行业属于周期性行业，行业增速与科技发展、全球经济形势高度相关，同时受技术升级、市场结构变化、应用领域升级、库存变化等因素的影响。2019 年，由于中美贸易摩擦，手机、汽车、数据中心等需求增长乏力等不利因素，半导体行业景气度整体下滑。2020 年 Q1 以来，半导体行业调整逐步进入尾声，但受疫情影响，景气度复苏有所延缓。从需求角度来看，5G 手机渗透率进一步提升，对半导体需求有显著拉动；同时，欧洲、中国等地区对于减少碳排放的要求将使得新能源汽车渗透率快速提升，进一步带动半导体行业景气度上行。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

在大直径单晶硅材料领域，凭借多年的技术积累及市场开拓，公司在产品成本、良品率、参数一致性和产能规模等方面均具备较为明显的竞争优势，细分市场占有率不断上升，市场地位和市场影响力不断增强。目前公司已成功进入国际先进半导体材料产业链体系，在行业内拥有了一定的知名度。报告期内，公司的 20 英寸以上超大直径单晶硅产品研发项目已取得重大突破。公司使用 28 英寸热场成功拉制直径达到 550mm(22 英寸)的晶体，其内在品质符合下游日本客户的标准，进一步巩固了公司在大直径单晶硅材料领域的技术地位。

（三）公司盈利水平及资金需求

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，公司提出 2020 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司目前处于快速发展的重要阶段，需要大量资金的支持。本次方案是兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，综合考虑公司所处行业特点，经营战略需求以及公司的资金需求安排，本着回报股东、促进公司稳健发展的因素而提出。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司未来将持续聚焦主业，公司留存的未分配利润主要用于研发投入、拓展新业务等发展需求，以此提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展。

公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配的相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》(赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票)。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者